

超配（维持）

## 半导体行业双周报（2025/05/30-2025/06/12）

WSTS 预测 2025 年全球半导体市场规模同比增长 11.2%

2025 年 6 月 13 日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

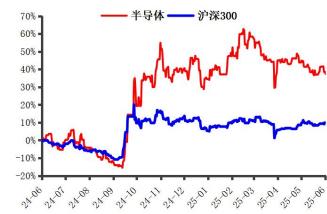
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

## 半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

## 投资要点：

- 半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2025年6月12日，半导体行业指数近两周（2025/05/30-2025/06/12）累计下跌1.43%，跑输沪深300指数2.30个百分点；2025年以来申万半导体行业指数累计下跌1.43%，跑输沪深300指数0.35个百分点。
- 细分板块涨跌幅：**截至2025年6月12日，申万半导体板块各细分指数近两周大多下跌，涨跌幅从高到低依次为：SW数字芯片设计（0.14%）>SW半导体材料（-1.40%）>SW集成电路封测（-1.59%）>SW分立器件（-1.71%）>SW模拟芯片设计（-2.41%）>SW半导体设备（-4.21%）。
- 行业新闻与公司动态：**（1）WSTS：2025年全球半导体市场规模达7009亿美元，同比增长11.2%；（2）Canalys：预计2025年AI手机渗透率将达到34%；（3）海关总署：前5个月集成电路出口额5264亿元，同比增长18.9%；（4）华为发布Pura80系列手机，6499元起售；（5）Arm官方认证：玄戒01芯片由小米自主研发；（6）集邦咨询：2025年全球晶圆代工产业将增长19.1%；（7）路维光电：公司二季度生产接近满载，将进一步布局14nm半导体掩膜版研发。
- 周报观点：**2025年以来外围扰动因素较大，市场噪音较多，对投资产生一定干扰。2025年一季度，受益人工智能持续推进、“国补”推动终端消费需求回暖以及设备、材料等环节自主可控加速推进，半导体板块经营业绩实现同比增长。展望2025年下半年，我们继续看好自主可控与人工智能两条主线。自主可控方面，虽然近年来我国半导体设备、材料国产替代取得一定进展，但在光刻、检测量测、离子注入等环节国产化率仍然偏低，重点把握相关领域设备、材料的国产替代机遇；此外，国际贸易新形势下国产模拟芯片导入、验证进程有望加速，关注工业、汽车等附加值高、国产化率低的细分领域；人工智能方面，以DeepSeek为代表的国产大模型引领模型平权，腾讯、阿里等云厂商资本开支同比提升，但海外英伟达H20等芯片断供加剧国内算力紧张，短期可能导致部分AI项目进展受阻，关注国产芯片的中长期替代进程；AI终端方面，Ray-Ban Meta引领AI智能眼镜热潮，而豆包视频模型上线有望加速终端的推广与渗透，预计智能眼镜渗透率有望快速提升，关注SOC、存储等成本占比较高的电子零部件。
- 风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。请务必阅读末页声明。

## 目录

1. 半导体行业行情回顾 .....	3
2. 半导体产业新闻 .....	4
3. 公司公告与动态 .....	6
4. 半导体产业数据更新 .....	7
4.1 智能手机出货数据 .....	7
4.2 新能源汽车销售数据 .....	7
4.3 全球、国内半导体月度销售数据 .....	8
5. 投资建议 .....	8
6. 风险提示 .....	12

## 插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2025 年 6 月 12 日) .....	3
图 2: 全球智能手机季度出货量 .....	7
图 3: 国内智能手机月度出货情况 .....	7
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率 .....	7
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率 .....	7
图 6: 全球半导体月度销售情况 .....	8
图 7: 中国半导体月度销售情况 .....	8

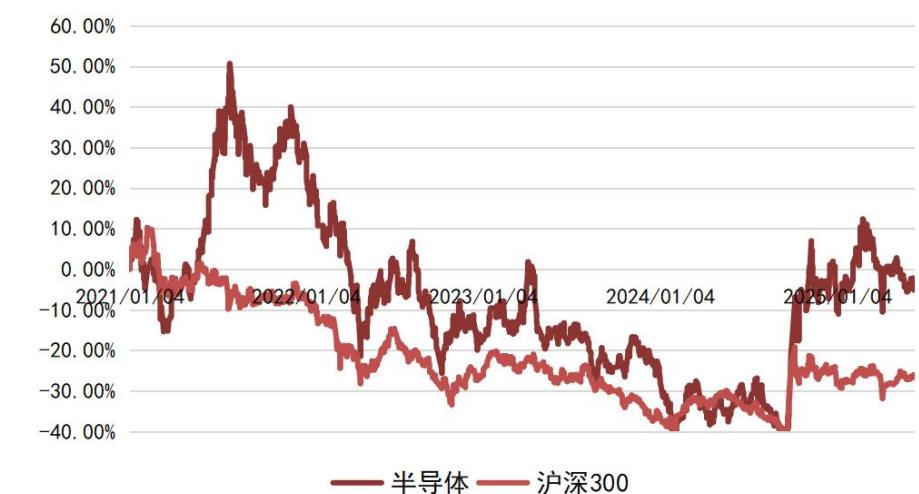
## 表格目录

表 1: 申万半导体行业各子板块涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2025 年 6 月 12 日) .....	3
表 2: 申万电子所有三级子行业涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2025 年 6 月 12 日) .....	3
表 3: 建议关注标的最新业绩情况 (截至 2025/06/12) .....	9

## 1. 半导体行业行情回顾

**半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至 2025 年 6 月 12 日，半导体行业指数近两周（2025/05/30-2025/06/12）累计下跌 1.43%，跑输沪深 300 指数 2.30 个百分点；2025 年以来申万半导体行业指数累计下跌 1.43%，跑输沪深 300 指数 0.35 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2025 年 6 月 12 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2025 年 6 月 12 日，申万半导体板块各细分指数近两周大多下跌，涨跌幅从高到低依次为：SW 数字芯片设计(0.14%)>SW 半导体材料(-1.40%)>SW 集成电路封测(-1.59%)>SW 分立器件 (-1.71%)>SW 模拟芯片设计 (-2.41%)>SW 半导体设备 (-4.21%)。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2025 年 6 月 12 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	-1.71	0.16	-5.58
2	850813.SL	半导体材料	-1.40	0.24	-0.10
3	850814.SL	数字芯片设计	0.14	1.55	4.94
4	850815.SL	模拟芯片设计	-2.41	-0.21	1.51
5	850817.SL	集成电路封测	-1.59	0.29	-17.58
6	850818.SL	半导体设备	-4.21	-2.37	-2.86

资料来源：iFind、东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2025 年 6 月 12 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	-1.40	0.24	-0.10
2	850818.SL	半导体设备	-4.21	-2.37	-2.86
3	850814.SL	数字芯片设计	0.14	1.55	4.94

4	850815. SL	模拟芯片设计	-2.41	-0.21	1.51
5	850817. SL	集成电路封测	-1.59	0.29	-17.58
6	850812. SL	分立器件	-1.71	0.16	-5.58
7	850853. SL	品牌消费电子	4.57	6.65	-8.82
8	850854. SL	消费电子零部件及组装	1.69	4.64	-7.53
9	850861. SL	电子化学品III	-0.63	0.85	3.90
10	850831. SL	面板	0.29	2.18	-8.15
11	850832. SL	LED	0.50	2.59	-3.32
12	850833. SL	光学元件	-0.44	2.65	-2.38
13	850822. SL	印制电路板	11.98	13.10	15.68
14	850823. SL	被动元件	-0.30	0.28	-10.88
15	850841. SL	其他电子III	4.32	7.21	1.31

资料来源: iFind、东莞证券研究所

## 2. 半导体产业新闻

### 1. 【WSTS: 2025 年全球半导体市场规模达 7009 亿美元 同比增长 11.2%】

《科创板日报》3 日讯, WSTS (世界半导体贸易统计协会) 报告称, 2025 年全球半导体市场规模将达到 7009 亿美元, 同比增长 11.2%。细分市场来看, 今年的半导体市场规模攀升将由逻辑和存储器的增长引领: 这两大市场均受到 AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动, 同比涨幅将达到两位数。

### 2. 【机构: 2025 年第一季度 DRAM 产业营收为 270.1 亿美元 预计二季度各主要应用合约价将止跌回升】

财联社 6 月 3 日电, 根据 TrendForce 集邦咨询最新调查, 2025 年第一季由于一般型 DRAM (Conventional DRAM) 合约价下跌, 加上 HBM 出货规模收敛, DRAM 产业营收为 270.1 亿美元, 季减 5.5%。在平均销售单价方面, 由于 Samsung (三星) 更改 HBM3e 产品设计, HBM 产能排挤效应减弱, 促使下游业者去化库存, 导致多数产品合约价延续 2024 年第四季以来的跌势。展望 2025 年第二季, 随着 PC OEM 和智能手机业者陆续完成库存去化, 并积极生产整机, 将带动位元采购动能升温, 原厂出货位元显著季增。价格方面, 预期各主要应用的合约价皆将止跌回升, 预估一般型 DRAM 合约价, 以及一般型 DRAM 和 HBM 合并的整体合约价均将上涨。

### 3. 【Canalys: 预计 2025 年 AI 手机渗透率将达到 34%】

《科创板日报》9 日讯, Canalys 预计 2025 年 AI 手机渗透率将达到 34%, 端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推 AI 手机向中端价位段渗透。2025 年芯片厂商发布的新款次旗舰 SoC 已经具备了流畅运行端侧大模型的能力, Deepseek 的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销, 在这两大因素的共同作用下, 2025-2026 年 AI 手机仍预计会保持高速渗透的趋势。

**4. 【机构：5月全球AI APP预估下载总量达2.8亿次 环比下滑16.4%】**

财联社6月7日电，点点数据显示，2025年5月，全球（含中国大陆）AI APP苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达2.8亿次（不含重复下载），环比4月下滑了16.4%。其中，ChatGPT、Google Gemini、DeepSeek、豆包与PixVerse位列TOP 5，占据了全球市场双端AI应用下载量的51%。具体来看，ChatGPT下载量占比进一步提升，由4月份的27%提升至5月份的32%，其余4款应用下载量占比相差不大。4月份位列第四的Genius在5月份跌出前五，取而代之的是在4月份跌出榜单的PixVerse位列5月份第五，豆包则前进一名成为第四。

**5. 【海关总署：前5个月集成电路出口额5264亿元 同比增长18.9%】**

财联社6月9日电，据海关统计，前5个月，我国出口机电产品6.4万亿元，增长9.3%，占我出口总值的60%。其中，自动数据处理设备及其零部件5752.3亿元，增长3.9%；集成电路5264亿元，增长18.9%；汽车3513.7亿元，增长6.6%。同期，出口劳密产品1.66万亿元，下降1.5%，占15.6%。其中，纺织品4201.4亿元，增长3.7%。出口农产品2960.9亿元，增长4.7%。

**6. 【IDC：2025年一季度全球腕戴设备市场同比增长10.5%】**

财联社6月11日电，国际数据公司（IDC）最新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2025年第一季度全球腕戴设备市场出货4,557万台，同比增长10.5%。除中国市场受到国补刺激增长显著之外，西欧、美国、拉美及亚太（除印度）等地区均受到全球市场复苏以及关税贸易影响加快出货节奏，呈现较为明显的增长。中国腕戴设备市场出货量为1,762万台，同比增长37.6%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中智能手表市场2025年第一季度全球出货量3,481台，同比增长4.8%；而中国智能手表市场出货量1,140万台，同比增长25.3%。手环市场2025年第一季度全球出货量1,076万台，同比增长34.0%；中国手环市场出货量621万台，同比增长67.9%。

**7. 【华为发布Pura80系列手机 6499元起售】**

《科创板日报》11日讯，在11日的华为新品发布会上，华为发布Pura80系列手机。该系列出厂搭载HarmonyOS 5.1操作系统，全系采用第八代ISP，配合一英寸RYYB超大底传感器。价格方面，华为Pura80 Pro售价6499元起，华为Pura80 Pro+售价7999元起。华为Pura80 Ultra售价9999元起。

**8. 【余承东：华为近十年研发费用为12490亿元】**

财联社6月11日电，在华为Pura80系列及全场景新品发布会上，余承东称，华为近十年研发费用为12490亿元。

**9. 【集邦咨询：2025年全球晶圆代工产业将增长19.1%】**

财联社6月12日电，在日前集邦咨询主办的“TSS 2025 半导体产业高层论坛”上，集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣指出，AI应用所带动高阶运算芯片需求持续强劲，

先进制程以及先进封装工艺均是全球晶圆代工产业的最大需求动力，预计 2025 年产业年增长率将达 19.1%。另外，先进工艺 2nm 将在今年下半年正式进入量产，先进封装产能也将持续扩大，预计年增长 76%。

#### 10. 【集邦咨询：HBM4 将在 2026 年第二季度量产】

财联社 6 月 12 日电，在日前集邦咨询主办的“TSS 2025 半导体产业高层论坛”上，集邦咨询分析师许家源指出，HBM 迭代快速，预计 HBM3e 将占据 2025 年出货份额超过 90%，2026 年 HBM4 将开始渗透入市场，供货商预计 2026 年第二季度量产。SK 海力士继续位居 HBM 主力供应商，美光快速追赶；英伟达维持 HBM 消费市场最大份额，预计 HBM 供需仍处平衡。另外，HBM 占整体内存产能比重持续提升下，排挤效应正重塑内存行业供给格局，预计 2025 年内存平均售价持续受 HBM 供需变化所影响。另外，集邦咨询分析师龚瑞骄指出，近年来 SiC 产业经历了大规模的产能扩张，6 英寸 SiC 晶圆已经供过于求，8 英寸转型进程有所减缓，以中国车企为代表的全球汽车业者高度重视 SiC 供应链布局。GaN 正处于大规模应用的临界点，由中低功率消费电子逐渐走向高功率应用，汽车、AI 数据中心、人形机器人等场景蕴藏巨大潜力。

### 3. 公司公告与动态

#### 1. 【拓荆科技吕光泉：一季度紧急出货致成本过高 属阶段性特殊情形】

《科创板日报》3 日讯，拓荆科技董事长吕光泉今日在业绩会上表示，公司今年一季度确认收入的部分新产品、新工艺成本较高，是为满足部分客户需求紧急出货所致，该情况的发生与相关国家出口管制政策、客户需求的紧迫程度及技术迭代节奏等多重因素有关，目前看属于阶段性的特殊情形，未来遇到类似情况的可能性较低。

“公司该等新产品大部分已经通过客户验证，逐步进入规模量产阶段，从长期来看，有利于促进公司与客户的长期合作，扩大公司设备市场占有率”。

#### 2. 【海光信息：拟以 143.46 元/股价格换股吸收合并中科曙光 股票复牌】

《科创板日报》9 日讯，海光信息(688041.SH)公告称，公司与中科曙光筹划由公司通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金。公司 A 股股票自 2025 年 5 月 26 日起停牌，并于 6 月 10 日开市起复牌。本次交易方案尚需再次审议及股东大会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施。

#### 3. 【路维光电：公司二季度生产接近满载 将进一步布局 14nm 半导体掩膜版研发】

财联社 6 月 11 日电，路维光电(688401.SH)在电话会议上表示，公司在二季度下游需求旺盛，生产接近满载。公司正加快在平板显示掩膜版以及半导体掩膜版的投资

节奏，多个扩产项目有条不紊推进。此外，公司计划进一步布局 14nm 半导体掩膜版的研发规划，以实现技术突破。

## 4. 半导体产业数据更新

### 4.1 智能手机出货数据

**全球智能手机出货数据：**根据 IDC 数据，2025 年一季度全球智能手机出货量为 3.05 亿台，同比增长 1.53%，环比下降 8.08%；2024 年全球智能手机出货量为 12.34 亿台，同比增长 6.17%。

**国内智能手机出货数据：**根据工信部数据，2024 年全年国内智能手机出货量为 2.94 亿台，同比增长 6.48%；2025 年 4 月国内智能手机出货量为 2,229.40 万台，同比下降 1.70%，环比增长 1.03%。

图 2：全球智能手机季度出货量



资料来源：IDC，东莞证券研究所

图 3：国内智能手机月度出货情况



资料来源：工信部，东莞证券研究所

### 4.2 新能源汽车销售数据

**新能源汽车销售数据：**据中汽协，2025 年 5 月，国内新能源汽车总销量为 130.7 万辆，同比增长 36.9%，环比增长 6.61%，2025 年 5 月国内汽车总销量为 268.6 万台，其中新能源汽车销量占比为 36.9%。

图 4：新能源汽车销量及同比增长率



资料来源：中汽协，东莞证券研究所

图 5：国内新能源汽车销量及渗透率



资料来源：中汽协，东莞证券研究所

### 4.3 全球、国内半导体月度销售数据

**全球、中国半导体销售数据:** 根据美国半导体行业协会数据, 2025年4月全球半导体销售额为569.6亿美元, 同比增长22.7%, 环比增长2.5%。国内方面, 国内2025年4月半导体销售额为162.0亿美元, 同比增长14.4%, 环比增长5.5%。

图6: 全球半导体月度销售情况

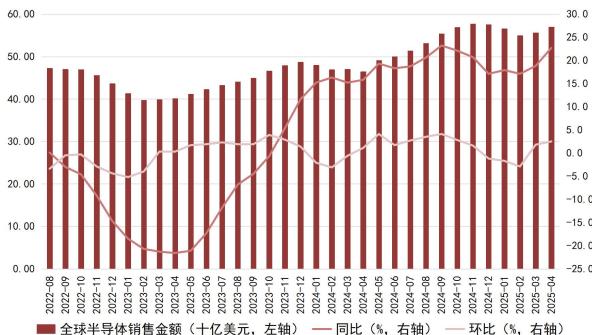
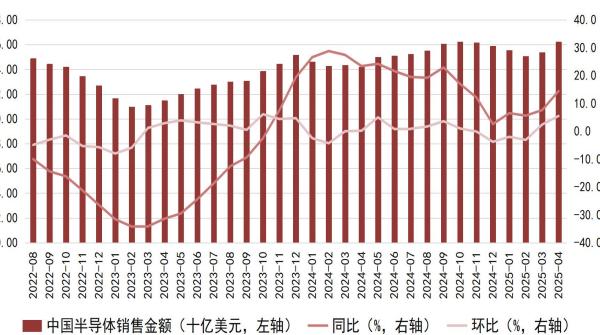


图7: 中国半导体月度销售情况



资料来源: 美国半导体产业协会, 东莞证券研究所

资料来源: 美国半导体产业协会, 东莞证券研究所

### 5. 投资建议

**把握不确定性中的确定性, 继续看好自主可控与人工智能浪潮。** 2025年以来外围扰动因素较大, 市场噪音较多, 对投资产生一定干扰。2025年一季度, 受益人工智能持续推进、“国补”推动终端消费需求回暖以及设备、材料等环节自主可控加速推进, 半导体板块经营业绩实现同比增长。**展望2025年下半年, 我们继续看好自主可控与人工智能两条主线。** **自主可控方面**, 虽然近年来我国半导体设备、材料国产替代取得一定进展, 但在光刻、检测量测、离子注入等环节国产化率仍然偏低, 重点把握相关领域设备、材料的国产替代机遇; 此外, 国际贸易新形势下国产模拟芯片导入、验证进程有望加速, 关注工业、汽车等附加值高、国产化率低的细分领域; **人工智能方面**, 以DeepSeek为代表的国产大模型引领模型平权, 腾讯、阿里等云厂商资本开支同比提升, 但海外英伟达H20等芯片断供加剧国内算力紧张, 短期可能导致部分AI项目进展受阻, 关注国产芯片的中长期替代进程; AI终端方面, Ray-Ban Meta引领AI智能眼镜热潮, 而豆包视频模型上线有望加速终端的推广与渗透, 预计智能眼镜渗透率有望快速提升, 关注SOC、存储等成本占比较高的电子零部件。

#### 建议关注标的:

**半导体设备:** 北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、长川科技(300604)、盛美上海(688082);

**半导体材料:** 鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)、雅克科技(002409);

**IC设计:** 兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、佰维存储(688525)、乐鑫科技(688018)、圣邦股份(300661)、思瑞浦(688536)、韦尔股份(603501)、思特威(688213)、海光信息(688041)；

**晶圆代工与半导体封测:** 中芯国际(688981)、长电科技(600584)、通富微电(002156)。

表 3: 建议关注标的最新业绩情况 (截至 2025/06/12)

股票代码	股票名称	最新业绩情况
002371	北方华创	公司 2024 年实现营业收入 298.38 亿元, 同比增长 35.14%, 实现归母净利润 56.21 亿元, 同比增长 44.17%, 公司 2025 年一季度实现营收 82.06 亿元, 同比增长 37.90%, 实现归母净利润 15.81 亿元, 同比增长 38.80%。受益下游逻辑代工大厂维持高资本开支扩产, 叠加多品类设备国产替代持续推进, 公司在手订单实现同比增长。3 月 10 日, 北方华创公告称以现金为对价, 协议受让先进制造持有的芯源微 9.49% 股份, 合计 19,064,915 股, 受让价格为 88.48 元/股, 交易金额为 1,686,863,679.20 元。作为国内半导体设备龙头企业, 北方华创在刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗等前道设备领域积累深厚, 但在光刻领域的涂胶显影设备方面存在短板, 而芯源微具备前道涂胶显影设备量产能力, 产品覆盖 28nm 以上制程, 且在化学清洗、先进封装湿法设备等方面有所布局。我们认为, 本次并购有助于双方产品形成互补, 可形成从前道制造到先进封装的全流程设备供应能力, 尤其是在光刻机联机作业、3D 集成等领域形成战略呼应, 增强企业长期竞争力。
688012	中微公司	公司 2024 年实现营业收入 90.65 亿元, 同比增长 44.73%, 实现归母净利润 16.16 亿元, 同比下降 9.53%。公司 2024 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 13.88 亿元, 较上年同期增加 16.51%。报告期内, 公司各业务进展顺利, 2024 年刻蚀设备销售约 72.77 亿元, 同比增长约 54.72%; MOCVD 设备销售约 3.79 亿元, 同比下降约 18.03%, LPCVD 设备 2024 年实现首台销售, 全年设备销售约 1.56 亿元。公司 2024 年营收、扣非后净利润同比增长, 但归母净利润同比下滑的主要原因为: 2023 年公司出售了持有的部分拓荆科技股份有限公司股票, 产生税后净收益约 4.06 亿元, 而 2024 年公司并无该项股权处置收益。2024 年一季度, 公司实现营收 21.73 亿元, 同比增长 35.40%, 实现归母净利润 3.13 亿元, 同比增长 25.67%, 主营业务维持增长态势。
688120	华海清科	公司 2024 年实现营收 34.06 亿元, 同比增长 35.82%, 实现归母净利润 10.23 亿元, 同比增长 41.40%, 公司 2025 年一季度实现营收 9.12 亿元, 同比增长 34.14%, 实现归母净利润 2.33 亿元, 同比增长 15.47%。报告期内, 公司凭借产品技术优势, 成功把握市场机遇, CMP 产品市场占有率和销售规模持续提高, 且公司持续加大研发投入和能力建设, 增强企业核心竞争力, 新产品研发和销售进展顺利, 减薄装备、清洗装备、晶圆再生、CDS 和 SDS 等初显市场成效, 提升了公司营收和盈利规模。
300604	长川科技	公司 2024 年实现营收 36.42 亿元, 同比增长 105.15%, 实现归母净利润 4.58 亿元, 同比增长 915.14%, 公司 2025 年一季度实现营收 8.15 亿元, 同比增长 45.74%, 实现归母净利润 1.11 亿元, 同比增长 2,623.82%。报告期内, 公司继续加快测试设备研发进程, 重点开拓了覆盖 SoC、逻辑等多种高端应用场景的数字测试设备、三温探针台、三温分选机、AOI 光学检测设备等相关封测设备, 不断拓宽产品线并积极开拓中高端市场, 带动营收、归母净利润实现同比增长。
688082	盛美上海	公司 2024 年实现营收 56.18 亿元, 同比增长 44.48%, 实现归母净利润 11.53 亿元, 同比增长 26.65%, 公司 2025 年一季度实现营收 13.06 亿元, 同比增长 41.73%, 实现归母净利润 2.46 亿元, 同比增长 207.19%。2024 年, 公司半导体清洗设备收入达 40.57 亿元, 同比增长 55.18%, 毛利率 46.17%。公司自主研发的 SAPS 和 TEBO 兆声波清洗技术解决了全球性难题, 具备显著技术优势。单片清洗设备最高可配置 18 腔体, Tahoe 清洗设备集成槽式和单片模块, 有效降低成本, 提升生产效率; 产品领域与研发投入方面, 公司产品线涵盖清洗设备、电镀设备、立式炉管设备等多个领域, 2024 年总收

表 3：建议关注标的最新业绩情况（截至 2025/06/12）

股票代码	股票名称	最新业绩情况
		入达 65.94 亿元，同比增长 38.51%。公司持续加大研发投入，2024 年申请专利 311 项，累计申请专利 1,526 项，拥有已授予专利权 470 项，其中发明专利 468 项。Ultr C Tahoe 设备减少 75% 化学品消耗，体现高效环保设计理念。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年实现营收 33.38 亿元，同比增长 25.14%，实现归母净利润 6.39 亿元，同比增长 122.00%，公司 2025 年一季度实现营收 8.24 亿元，同比增长 16.37%，实现归母净利润 1.41 亿元，同比增长 72.84%。2024 年，公司加大对 CMP 抛光液、高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料、新领域芯片等业务领域的研发投入，全年研发投入为 4.62 亿元，同比增长 21.01%，占营收比重达 13.84%。受益研发驱动公司业务发展，公司 2024 年、2025 年一季度各产品销售情况顺利，其中 CMP 抛光垫 2024 年收入达 7.16 亿元，同比增长 71.51%，CMP 抛光液与清洗液收入为 2.15 亿元，同比增长 178.89%。
300666	江丰电子	公司 2024 年实现营收 36.05 亿元，同比增长 38.57%，实现归母净利润 4.01 亿元，同比增长 56.79%，公司 2025 年一季度实现营收 10.00 亿元，同比增长 29.53%，实现归母净利润 1.57 亿元，同比增长 163.58%。报告期内，公司靶材业务进展顺利，2024 年靶材业务收入为 23.33 亿元，同比增长 39.5%，在技术、市场份额均跻身全球领先水平；半导体零部件业务方面，公司 2024 年半导体零部件业务实现营收 8.87 亿元，同比增长 55.53%，营收占比为 24.6%，成为公司业绩的第二增长点。2025 年一季度，公司主营业务维持同比增长态势，且转让联营企业上海润平部分股权也进一步抬高公司归母净利润增速。
002409	雅克科技	公司 2024 年实现营收 68.62 亿元，同比增长 44.84%，实现归母净利润 8.72 亿元，同比增长 50.41%。公司 2025 年一季度实现营收 21.18 亿元，同比增长 30.88%，实现归母净利润 2.60 亿元，同比增长 5.85%。报告期内，公司继续深耕电子材料、液化天然气 (LNG) 保温绝热板材以及阻燃剂三大产品领域，其中前驱体业务已实现了 12 寸晶圆客户端全覆盖，显示面板用光刻胶已进入京东方、华星光电、LG Display 等头部显示面板制造企业供应链，产品质量和技术继续保持业内领先地位。
603986	兆易创新	公司 2024 年实现营收 73.56 亿元，同比增长 27.69%，实现归母净利润 11.03 亿元，同比增长 584.21%；公司 2025 年一季度实现营收 19.09 亿元，同比增长 17.32%，实现归母净利润 2.35 亿元，同比增长 14.57%。2024 年，公司继续保持以市场占有率为策略，持续进行研发投入和产品迭代，不断优化产品成本并丰富产品矩阵，在消费、网通、计算等多个领域均实现收入、销量同比增长。2025 年一季度，受益国家一揽子政策刺激终端电子产品需求，以及 AI 手机、AI PC 带动存储容量需求提升，公司经营业绩保持正向增长。
688008	澜起科技	公司 2024 年实现营收 36.39 亿元，同比增长 59.20%，实现归母净利润 14.12 亿元，同比增长 213.10%；公司 2025 年一季度实现营收 12.22 亿元，同比增长 65.78%，实现归母净利润 5.25 亿元，同比增长 135.14%。2024 年，全球服务器及计算机需求回暖，公司把握行业复苏机遇，持续加大技术创新和市场拓展，带动经营业绩实现显著增长。内存接口芯片方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，同时受益于 DDR5 下游渗透率提升且子代持续迭代，公司 DDR5 内存接口芯片出货量超过 DDR4 内存接口芯片，DDR5 第二子代内存接口芯片出货量超过第一子代产品；另一方面，受益于 AI 产业趋势推动，公司三款高性能运力芯片新产品 (PCIe Retimer、MRCD/MDB 及 CKD) 开始规模出货，其中：PCIe Retimer 芯片在下游实现规模应用，MRCD/MDB 芯片及 CKD 芯片开始在行业规模试用，三款新产品合计销售收入约为 4.22 亿元，是上年度的 8 倍，为公司贡献新的业绩增长点。分业务来看，公司互连类芯片产品线实现销售收入 33.49 亿元，较上年度增长 53.31%，毛利率为 62.66%，较上年度提升 1.30 个百分点；津逮服务器平台产品线实现销售收入 2.80 亿元，较上年度增长 198.87%。
688525	佰维存储	公司 2024 年实现营收 66.95 亿元，同比增长 86.46%，实现归母净利润 1.35 亿元，同比增长 121.44%；公司 2024 年一季度实现营收 15.43 亿元，同比下降 10.62%，实现归母净利润 -1.97 亿元，同比下降 217.87%。受全球宏观经济影响，存储价格从 24Q3 开始逐季下滑，25Q1 达到阶段性低点，公司产品销售价格降幅较大，导致 25Q1 营业收入同比下滑 10.62%，销售毛利率同比下降 22.75 个百分点；随

**表 3：建议关注标的最新业绩情况 (截至 2025/06/12)**

股票代码	股票名称	最新业绩情况
		着存储价格从 2025 年第二季度开始企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善；此外，受客户项目节奏影响，第一季度公司面向 AI 眼镜、AI 手机等领域的高价值产品销售金额较低，随着上述产品从第二季度开始批量交付，公司的营业收入和毛利率有望进一步回升。公司在业绩交流会上表示，2024 年公司面向 AI 眼镜产品收入约 1.06 亿元，预计 2025 年公司面向 AI 眼镜产品收入有望同比增长超过 500%。
688018	乐鑫科技	公司 2024 年实现营收 20.07 亿元，同比增长 40.04%，实现归母净利润 3.39 亿元，同比增长 149.13%；公司 2025 年一季度实现营收 5.58 亿元，同比增长 44.08%，实现归母净利润 0.94 亿元，同比增长 73.80%。公司在 Wi-Fi MCU 市场占据领先地位，通过高性能、低功耗的 ESP32 系列芯片和多协议支持（Wi-Fi、蓝牙）的技术优势，满足了不同应用场景的需求，巩固其市场地位；此外，公司积极拓展 AIoT SoC 业务，提供从芯片设计到软件开发、云服务的全栈解决方案。公司推出的 ESP RainMaker 平台，集成了设备管理、远程控制、数据分析等功能，简化了物联网设备的开发和管理流程，展示了其在 AIoT 领域的强大竞争力。
300661	圣邦股份	公司 2024 年实现营收 33.47 亿元，同比增长 27.96%，实现归母净利润 5.00 亿元，同比增长 78.17%；公司 2025 年一季度实现营收 7.90 亿元，同比增长 8.30%，实现归母净利润 0.60 亿元，同比增长 9.90%。2024 年，公司产品结构有所优化，高端化产品占比提高，带动归母净利润增速显著高于营收增速；研发投入方面，公司 2024 年研发费用支出 8.71 亿元，占营收比重 26.02%，研发人员 1,184 人，占公司员工总数 74.09%，研发投入、研发人员数量逐年增加。2025 年一季度，公司经营业绩保持平稳增长，单季度销售毛利率为 49.07%，受行业季节性影响环比略有下滑，但仍高于行业均值，经营韧性凸显。
688536	思瑞浦	公司 2024 年实现营收 12.20 亿元，同比增长 11.52%，实现归母净利润-1.97 亿元，同比下降 468.13%；公司 2025 年一季度实现营收 4.22 亿元，同比增长 110.88%，实现归母净利润 0.16 亿元，同比增长 131.65%。2024 年，受产品结构变动及市场竞争等因素影响，公司产品价格和毛利率阶段性承压，此外期间研发、销售费用增加，以及公司计提存货跌价准备等因素导致全年归母净利润为负；2025 年一季度，下游汽车、泛工业、泛通信等领域需求恢复，公司经营业绩迎来拐点，营收、净利润实现同比、环比增长。
603501	韦尔股份	公司 2024 年实现营收 257.31 亿元，同比增长 22.41%，实现归母净利润 33.23 亿元，同比增长 498.11%；公司 2025 年一季度实现营收 64.72 亿元，同比增长 14.68%，实现归母净利润 8.66 亿元，同比增长 55.25%。报告期内，公司积极推进产品结构优化，产品向高端化方向进展顺利。智能手机方面，公司所推出的 1.2um 5,000 万像素高端图像传感器 OV50H，凭借其优异的性能被广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄方案中，伴随着产能顺利爬坡，公司在高端智能手机领域市场份额持续提升。2024 年，公司图像传感器业务来源于智能手机市场的收入约 98.02 亿元，较上年同期增加 26.01%；车载业务方面，公司凭借先进紧凑的汽车 CIS 解决方案已经覆盖了 ADAS、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等广泛的汽车应用，产品表现出的优秀性能也帮助公司导入更多新的设计方案。2024 年，公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入实现约 59.05 亿元，较上年同期增加 29.85%，市场份额持续提升。
688213	思特威	公司 2024 年实现营收 59.68 亿元，同比增长 108.87%，实现归母净利润 3.93 亿元，同比增长 2,662.76%，公司 2025 年一季度实现营收 17.50 亿元，同比增长 108.94%，实现归母净利润 1.91 亿元，同比增长 1,264.97%，2024 年，2025 年一季度归母净利润均实现同比大幅增长。2024 年，公司各项业务进展顺利，在全球安防 CIS 中出货排名蝉联第一位，市场份额达到 48.2%，车载 CIS 出货排名位列第四位，国内排名第 2 位；全球手机 CIS 市场出货排名位列第 5 位，出货份额占比达到 11.2%；2025 年一季度，公司在智能手机与高端车载市场客户市占率继续提高，经营业绩维持高速增长态势，单季度营收、归母净利润均创历史同期新高。

**表 3：建议关注标的最新业绩情况 (截至 2025/06/12)**

股票代码	股票名称	最新业绩情况
688041	海光信息	公司 2024 年实现营收 91.62 亿元，同比增长 52.40%，实现归母净利润 19.31 亿元，同比增长 52.87%；公司 2025 年一季度实现营收 24.00 亿元，同比增长 50.76%，实现归母净利润 5.06 亿元，同比增长 75.33%。2024 年和 2025 年一季度，公司整体经营情况持续向好，尤其是在高端处理器产品的产业生态版图不断拓展，涉及的行业应用以及新兴人工智能大模型产业逐步增加。分产品来看，公司 CPU 产品已支持了广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景，市场份额逐步提高；DCU 产品则以高算力、高并行处理能力、良好的软件生态支持了算力基础设施、商业计算等行业应用。
688981	中芯国际	公司 2024 年实现营收 577.96 亿元，同比增长 27.72%，实现归母净利润 36.99 亿元，同比下降 23.31%。公司 2025 年一季度实现营收 163.01 亿元，同比增长 29.44%，实现归母净利润 13.56 亿元，同比增长 166.50。公司预计 2025 年二季度销售收入环比下降 4% 到 6%，毛利率预计在 18% 到 20% 之间。公司 2025 年一季度销售收入实现同比、环比增长，主要受益于国际形势变化引起的客户提拉出货，国内以旧换新、消费补贴等政策推动的大宗类产品的需求上升，以及工业与汽车产业的触底补货；公司整体出货数量达到 229 万片折合八英寸标准逻辑晶圆，出货量环比增长 15%。但由于工厂生产性波动，一季度后半部平均销售单价下降，导致收入未能达到指引预期；这个影响会延续到二季度。
600584	长电科技	公司 2024 年实现营收 359.62 亿元，同比增长 21.24%，实现归母净利润 16.10 亿元，同比增长 9.44%，公司 2025 年一季度实现营收 93.35 亿元，同比增长 36.44%，实现归母净利润 2.03 亿元，同比增长 50.39%。2024 年，受益人工智能驱动、智能手机回暖和下游晶圆厂持续扩产，全球半导体行业持续回暖。作为全球封测龙头企业，公司在报告期内持续聚焦尖端技术和重点应用市场与客户，深耕通讯、消费、运算和汽车电子四大核心应用领域，通过优化产品结构、提升产能利用率、加强成本控制等措施保持了盈利能力的稳定，2024 年营收创历史新高；2025 年一季度，国内外先进封装市场订单维持增长，叠加晟碟半导体（上海）有限公司财务并表影响，带动公司营收实现同比增长。
002156	通富微电	公司 2024 年实现营收 238.82 亿元，同比增长 7.24%，实现归母净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。公司 2025 年一季度实现营收 60.92 亿元，同比增长 15.34%，实现归母净利润 1.01 亿元，同比增长 2.94%。2024 年，全球半导体行业逐步进入上行周期，公司积极调整产能布局，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在品质提升、技术研发、新工厂建设、营运及人才融合等方面收获良好的效益；2025 年一季度，公司维持良好经营态势，营收、净利润均实现同比增长，且营收创历史同期新高。

资料来源：iFind，东莞证券研究所

## 6. 风险提示

- (1) **终端需求不及预期：**智能手机、PC 构成半导体的主要下游应用领域之一，若后续下游需求持续性不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；
- (2) **国产替代不及预期：**若半导体设备、材料等企业技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；
- (3) **价格竞争加剧：**若业内上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，导致无法给出明确的投资评级；股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明：本评级体系的“市场指数”，A股参照标的为沪深 300 指数；新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告，市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板（含退市整理期）等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告，港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系：“保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报，“谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报，“稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报，“积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报，“激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

**证券分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券股份有限公司研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22115843

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)